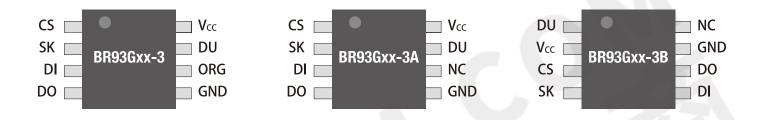




存储器选型指南



DRAM (LAPIS): 具有丰富的封装品、及最适于SiP用的可确保KGD的芯片产品,保证长期稳定供应。拥有能与图像尺寸吻合的产品,齐集了作为图像用存储器专用的产品阵容。

串行EEPROM:适用于数据保存、容量大小、总线接口及封装类型市场上最齐全,包含通用型和车规型。

FeRAM (LAPIS): 通过铁电工程与硅栅极技术所开发的32kbit-256kbit的范围构成的铁电随机存取存储器。具备不需要使用电池的备份、可以高速度地随机读写、有高读写寿命-保障约1兆次、低功耗工作。多样应用程序适应等特点。

NOR Flash (LAPIS): 交期稳定,由浮置栅极的存储单元构成、具备存储容量不仅为128Mb以下的 Single Level Sel(SLS) 还是为128Mb以上的Multi Level Sel(MLS); 具备通过纠错码电路的比特错误校正功能、实现高度的保护数据特性。

P2ROM (LAPIS): P2ROM™是由蓝碧石半导体将客户的ROM数据进行写入出货的、独创的读取专用的非易失性存储器。

本资料所涉及产品主要应用于:

物联网,通信,医疗设备,汽车电子,工业自动化,安防监控,电机控制,智能家居, 无线传感等

SEKORM 世强

全球先进元件分销

服务热线: 40088 73266

www.sekorm.com Email: Service@sekorm.com



About SEKORM

关于世强

- 世强,1993年在深圳成立,是中国电子行业最优秀的半导体分销商。
- 全球三十几家著名半导体企业大中国区分销商,产品覆盖工业电子、消费电子、通信电子、智能物联、汽车电子、测试测量等领域。
- 上万家电子制造和研发企业的元件供应商,与各大领域的客户平均合作时间高达10年以上,客户既有蜚声全球的世界500强,也有崭露头角的新兴企业。
- 2016年1月11日正式上线中国首个智能硬件创新服务平台,世强元件电商。
- 为硬件工程师、采购、管理者度身订制,服务10万创新企业,100万创新工程师。
- 为工程师提供从新元件新技术资讯、创新解决方案、研发所需的一切资料、到资深专家技术支持、大神经验分享、再到完善的元器件供应的一条龙服务。



工业电子

工业控制领域最大的电子元件供应商

工业4.0、变频、伺服、机器人、可再生能源、充电桩、智能电网、工业电源、智能四表、 安防、医疗、轨道交通、无人机、人工智能

⁽⁽⁾⁾通信及高可靠设备

国内最大的射频微波元件供应商

基站及基站天线、光通信设备、数据通信、卫星通信、微波通信、雷达及其他高可靠设备

汽车电子

最具产品实力和方案优势的汽车电子元件供应商

BCM、BMS、数字仪表盘、车载娱乐、新能源汽车、EPS、无人驾驶、ADAS、倒车雷达、胎压监测系统、RKE/PKE、APA、PEPS、HUD



智能物联

提供传感、控制、组网三位一体最完整的解决方案

可穿戴设备、智能家居、智能家电、智能监控、智能计量、智能手机、仓储物流、智能社区

Ĺ 消费电子

最主要的智能手机和新型家电关键元件供应商

智能手机、便携数码、个人保健、个人代步工具、玩具及娱乐设备



中国基础电子测量仪器最大供应商

示波器、频谱仪、信号源、网络分析仪、电源、数采、频率计、功率计、万用表、函数发生器、 LCR表、电子负载、射频微波测试附件,测试天线

About Rohm

关于罗姆

Rohm(罗姆)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。

"品质第一"是罗姆的一贯方针。其产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。



IC

存储器

CONTENTS

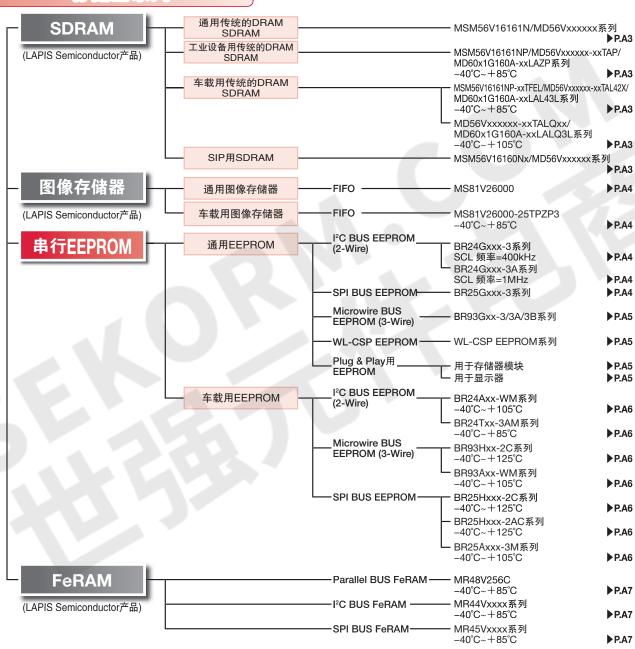


SDRAM P. A3
通用传统的DRAM SDRAM(包含LAPIS Semiconductor产品) · · · · · · P. A3
工业设备用传统的DRAM SDRAM(包含LAPIS Semiconductor产品) ····· P. A3
车载用传统的DRAM SDRAM(包含LAPIS Semiconductor产品) ······· P. A3
SiP用SDRAM(包含LAPIS Semiconductor产品) · · · · P. A3
图像存储器····································
通用图像存储器(包含LAPIS Semiconductor产品) ······· P. A4
车载用图像存储器(包含LAPIS Semiconductor产品) ······· P. A4
串行EEPROM P. A4
通用EEPROM ······P. A4
车载用EEPROM ······ P. A6
FeRAM P. A7
铁电随机存取存储器(包含LAPIS Semiconductor产品) ·········· P. A7

通用IC

存储器系列

存储器系列





SDRAM

通用传统的DRAM SDRAM

(LAPIS Semiconductor产品)

标准												
Part No.	Data Rate Type	Supply Voltage (V)	Density (bit)		Configuration (bank × word × bit)	Max. Operating Frequency (MHz)	Refresh Cycle (cycles/ms)	Cycle Time (ns)	Features	Operating Temperature Ta(°C)	Package	Halogen Free Support*1
MSM56V16161N			16M		2×512K×16	143		7/7.5/10			TSOP()50	V
MD56V62161M	SDR	00.00	64M		4×1M×16	143	4096/64	7/7.5/10	Drivability	0.4 70		V
MD56V72161C	SDR	3.3±0.3	128M	×16	4×2M×16	166		6/7/7.5/10	Control	0 to +70	TSOP()54	V
MD56V82161A			256M		4×4M×16	166	8192/64	6/7/7.5/10				V

工业设备用传统的DRAM SDRAM

(LAPIS Semiconductor产品)

工业												
Part No.	Data Rate Type	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Number of Data bits	Configuration (bank × word × bit)	Max. Operating Frequency (MHz)	Refresh Cycle (cycles/ms)	Cycle Time (ns)	Features	Operating Temperature Ta(°C)	Package	Halogen Free Support*1
MSM56V16161NP			16M		2×512K×16	143		7/7.5/10			TSOP()50	~
MD56V62161M-xxTAP	SDR	3.3±0.3	64M	×16	4×1M×16	143	4096/64	7/7.5/10	Drivability	-40 to +85		V
MD56V72161C-xxTAP	SDN	3.3±0.3	128M	_ ^10	4×2M×16	166		6/7/7.5/10	Control	-40 10 +65	TSOP(II)54	V
MD56V82161A-xxTAP			256M		4×4M×16	166	8192/64	6/7/7.5/10				~
☆MD60Y1G160A-xxLAZP	DDR3	1.5±0.075	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at T _C ≤85°C, 3.9µs at T _C >85°C	1.25/1.5		-40 to +95	96-ball FBGA	~
☆MD60S1G160A-xxLAZP	DDR3L	1.35 +0.1,-0.067	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at Tc≤85°C, 3.9µs at Tc>85°C	1.25/1.5	-	-40 to +95	96-ball FBGA	~

车载用传统的DRAM SDRAM

(LAPIS Semiconductor产品)

车载(85℃工作温度)							-						
Part No.	Data Rate Type	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Number of Data bits	Configuration (bank × word × bit)	Max. Operating Frequency (MHz)	Refresh Cycle (cycles/ms)	Cycle Time (ns)	Features	Operating Temperature Ta(°C)	Package	Halogen Free Support*1	Automotive Grade AEC-Q100
MSM56V16161NP-xxTFEL			16M		2×512K×16	143		7/7.5/10			TSOP(II)50	V	YES
MD56V62161M-xxTAL42X	SDR	3.3±0.3	64M	×16	4×1M×16	143	4096/64	7/7.5/10	Drivability	40 to 105			
MD56V72161C-xxTAL42X	SDR	3.3±0.3	128M	×Ib	4×2M×16	166		6/7/7.5/10	Control	-40 to +85	TSOP(II)54	V	YES
MD56V82161A-xxTAL42X			256M		4×4M×16	166	8192/64	6/7/7.5/10					
☆MD60Y1G160A-xxLAL43L	DDR3	1.5±0.075	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at Tc≤85°C, 3.9µs at Tc>85°C	1.25/1.5	-	-40 to +95	96-ball FBGA	~	YES
☆MD60S1G160A-xxLAL43L	DDR3L	1.35 +0.1,-0.067	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at Tc≤85°C, 3.9µs at Tc>85°C	1.25/1.5	-	-40 to +95	96-ball FBGA	/	YES
车载(105℃工作温度)	. 4	1	3	1									
MD56V62161M-xxTALQ2X			64M		4×1M×16	143	1000/10	7/7.5/10					
MD56V72161C-xxTALQ2X	SDR	3.3 ± 0.3	128M	×16	4×2M×16	166	4096/16	6/7/7.5/10	Drivability Control	-40 to +105	TSOP(II)54	\ \ \ \	YES
MD56V82161A-xxTALQ2X		N 0	256M		4×4M×16	166	8192/16	6/7/7.5/10					
☆MD60Y1G160A-xxLALQ3L	DDR3	1.5±0.075	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at Tc≤85°C, 3.9µs at Tc>85°C	1.25/1.5	-	-40 to +105	96-ball FBGA	/	YES
☆MD60S1G160A-xxLALQ3L	DDR3L	1.35 +0.1,-0.067	1G	×16	8×8M×16	800 (1600Mbps)	Average refresh period : 7.8µs at Tc≤85°C, 3.9µs at Tc>85°C	1.25/1.5	-	-40 to +105	96-ball FBGA	~	YES

DDR3 : Double Data Rate3 Synchronous DRAM, SDR : Single Data Rate Synchronous DRAM *1:帶元卤素标记 / 、表示备有无卤素产品。 详细内容请咨询销售人员。

☆:开发中

SiP用SDRAM

(LAPIS Semiconductor产品)

标准											
Part No.	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Number of Data bits	Configuration (bank × word × bit)	Max. Operating Frequency (MHz)	Refresh Cycle (cycles/ms)	Cycle (ns			perating nperature Tj(°C)	Features
MSM56V16160N		16M		2×512K×16	166		6/7/7.5	/8/10			
MD56V62160M	3.3 ± 0.3	64M	×16	4×1M×16	143	4096/32	7/7.5/8	8/10	-40	0 to +125	KGD
MD56V72160C		128M		4×2M×16	166		6/7/7.	5/10	-40 to 4		
车载											
Part No.	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Number of Data bits	Configuration (bank × word × bit)	Max. Operating Frequency (MHz)	Refresh Cycle (cycles/ms)	Cycle Time (ns)	Operatir Temperat Tj(°C)		Features	Automotive Grade*2
MSM56V16160NP		16M		2×512K×16	166		6/7/7.5/8/10				
MD56V62160M	3.3 ± 0.3	64M	×16	4×1M×16	143	4096/16	7/7.5/8/10	-40 to +1	125	KGD	YES
MD56V72160C		128M		4×2M×16	166		6/7/7.5/10				

^{*2:}关于AEC-Q100,请咨询销售人员。

图像存储器

通用图像存储器

(LAPIS Semiconductor产品)

标准													
Part No.	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Configuration (word × bit) × port	Number of Data bits	Max. Operating Frequency (MHz)	Access Time (ns)	Time	Power Consu	· · · ·	Temperature	Package	Notes	Halogen Free Support*1
MS81V26000	3.3 ± 0.3	26M	1,114,112×24	× 24	100	8/9	10/12	648/576	18	0 to +70	TQFP100	Asynchronous serial read/write, Write mask function, Output data control, Cascade, The top address can be specified	~

车载用图像存储器

(LAPIS Semiconductor产品)

车载														
Part No.	Supply Voltage (V)	Density (bit)	Configuration (word × bit) × port	Number of Data bits	Max. Operating Frequency (MHz)	Access Time (ns)	Time	Power Consu Operating		Operating Temperature Ta(°C)	Package	Notes	Halogen Free Support*1	Automotive Grade*2
MS81V26000-25TPZP3	3.3 ± 0.3	26M	1,114,112×24	× 24	40	12	25	576	18	- 40 to +85	TQFP100	Asynchronous serial read/write, Write mask function, Output data control, Cascade, The top address can be specified	~	YES

^{*1:}带无卤素标记 / ,表示备有无卤素产品。 详细内容请咨询销售人员。 *2:关于AEC-Q100,请咨询销售人员。

串行EEPROM

通用EEPROM

理用EEPROI	VI												200					
I ² C BUS EEI	PROM	(2-W	ire) BR	24Gx	(x-3系	列 (SC	L频率	= 4001	kHz)				9				ا اسراک خ	4
				Package	and Suffix				Dit.	Dit 5	Supply	Current Co	nsumption(Max.)	Write Cycle	SCL	Operating	F. d.	Data
Part No.	SOP8	SOP-J8	SSOP-B8	TSSOP-B8	MSOP8	TSSOP-B8J	VSON008X2030	VMMP008Z1830	Density (bit)	Bit Forma (word × bi	II Valtage		g Standby (μA)	Time (Max.)(ms)	Frequency	Temperature (°C)	Endurance (times)	Retention (years)
BR24G01	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-	1K	128×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K			
BR24G02	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-	2K	256×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K	70		
BR24G04	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	V	4K	512×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K			
BR24G08	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-	8K	1K×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K			
BR24G16	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	QUZ-3	16K	2K×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K	-40 to +85	10 ⁶	40
BR24G32	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-3	32K	4K×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K			
BR24G64	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-	64K	8K×8	1.6 to 5	.5 2	2	5	400K			
BR24G128	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	FVM-3	FVJ-3	NUX-3	-	128K	16K×8	1.6 to 5	.5 2.5	2	5	400K			
BR24G256	F-3	FJ-3	FV-3	FVT-3	4	-	1		256K	32K×8	1.6 to 5	.5 2.5	2	5	400K			
I ² C BUS EEI	PROM	(2-W	ire) BR	24Gx	(x-3A)	系列 (S	CL频率	率 = 1M	Hz)									
BR24G01	F-3A	FJ-3A	^	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	- \	1K	128×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G02	F-3A	FJ-3A) - \	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	-	2K	256×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G04	F-3A	FJ-3A	4	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	-	4K	512×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G08	F-3A	FJ-3A	-	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	-	8K	1K×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G16	F-3A	FJ-3A	-\-	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	-	16K	2K×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G32	F-3A	FJ-3A	FV-3A	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	QUZ-3A	32K	4K×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M	-40 to +85	10 ⁶	40
BR24G64	F-3A	FJ-3A	FV-3A	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	QUZ-3A	64K	8K×8	1.7 to 5	.5 2	2	5	1M			
BR24G128	F-3A	FJ-3A	FV-3A	FVT-3A	FVM-3A	FVJ-3A	NUX-3A	-	128K	16K×8	1.7 to 5	.5 2.5	2	5	1M			
BR24G256	F-3A	FJ-3A	FV-3A	FVT-3A	-	-	-	-	256K	32K×8	1.7 to 5	.5 2.5	2	5	1M			
BR24G512	F-3A	FJ-3A	-	FVT-3A	-	-	-	-	512K	64K×8	1.7 to 5	.5 4.5	3	5	1M			
BR24G1M	F-3A	FJ-3A	-	-	-	-	-	-	1M	128K×8	1.7 to 5	.5 4.5	3	5	1M			
Microwire E	BUS EI	EPRO	M (3-V	/ire) B	R93G	cx-3/3	A/3B系	列										
				Packa	age and Su	ıffix				Density B	it Format	Supply	Current Con	sumption(Max.)	Write Cycle	Operating	Endurance	Data
Part No.	SOF	28	SOP-J8	з т	SSOP-B8	М	SOP8	VSON008	8X2030		ord × bit)	Voltage (V)	Operating (mA)	Standby (µA)	Time (Max.)(ms)	Temperature (°C)	(times)	Retention (years)
BR25G320	F-3	3	FJ-3		FVT-3	F	VM-3	NUX	(-3	32K	4K×8	1.6 to 5.	8	2	5			
BR25G640	F-3	3	FJ-3		FVT-3	F	VM-3	NUX	(-3	64K	8K×8	1.6 to 5.	8	2	5]		
BR25G128	F-3	3	FJ-3		FVT-3	F	VM-3	NUX	(-3	128K	16K×8	1.6 to 5.	8	2	5	-40 to	10 ⁶	100
BR25G256	F-3	3	FJ-3		FVT-3		-	-		256K	32K×8	1.6 to 5.	8	2	5	+ 85	10-	100
BR25G512	F-3	3	FJ-3		FVT-3		-	-		512K	64K×8	1.8 to 5.	5 4	1	5			
BR25G1M	F-3	3	FJ-3		-		-	-		1M	128K×8	1.8 to 5.	5 4	1	5			



Microwire E	SUS EEPRO	OM (3-Wire) BR93Gxx	-3/3A/3B系	列									
		ı	Package and Suffi	x			D	Supply	Current Cons	umption(Max.)	Write Cycle	Operating		Data
Part No.	SOP8	SOP-J8	TSSOP-B8	MSOP8	VSON008X3020	Density (bit)	Bit Format (word × bit)	Voltage (V)	Operating (mA)	Standby (µA)	Time (Max.)(ms)	Temperature (°C)	Endurance (times)	Retention (years)
BR93G46	F-3*1/ F-3A*2/ F-3B*3	FJ-3*1/ FJ-3A*2/ FJ-3B*3	FVT-3*1/ FVT-3A*2/ FVT-3B*3	FVM-3*1/ FVM-3A*2/ FVM-3B*3	NUX-3*1/ NUX-3A*2/ NUX-3B*3	1K	64×16 (128×8)	1.7 to 5.5	3	2	5			
BR93G56	F-3*1/ F-3A*2/ F-3B*3	FJ-3*1/ FJ-3A*2/ FJ-3B*3	FVT-3*1/ FVT-3A*2/ FVT-3B*3	FVM-3*1/ FVM-3A*2/ FVM-3B*3	NUX-3*1/ NUX-3A*2/ NUX-3B*3	2K	128 × 16 (256 × 8)	1.7 to 5.5	3	2	5			
BR93G66	F-3* ¹ / F-3A* ² / F-3B* ³	FJ-3*1/ FJ-3A*2/ FJ-3B*3	FVT-3* ¹ / FVT-3A* ² / FVT-3B* ³	FVM-3*1/ FVM-3A*2/ FVM-3B*3	NUX-3*1/ NUX-3A*2/ NUX-3B*3	4K	256 × 16 (512 × 8)	1.7 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	10 ⁶	40
BR93G76	F-3*1/ F-3A*2/ F-3B*3	FJ-3*1/ FJ-3A*2/ FJ-3B*3	FVT-3*1/ FVT-3A*2/ FVT-3B*3	FVM-3*1/ FVM-3A*2/ FVM-3B*3	NUX-3*1/ NUX-3A*2/ NUX-3B*3	8K	512×16 (1K×8)	1.7 to 5.5	3	2	5			
BR93G86	F-3* ¹ / F-3A* ² / F-3B* ³	FJ-3*1/ FJ-3A*2/ FJ-3B*3	FVT-3* ¹ / FVT-3A* ² / FVT-3B* ³	FVM-3*1/ FVM-3A*2/ FVM-3B*3	NUX-3*1/ NUX-3A*2/ NUX-3B*3	16K	1K×16 (2K×8)	1.7 to 5.5	3	2	5			

Microwire BUS EEPROM (3-Wire) BR93Gxx-3/3A/3B 系列:*1 向ORG PIN输入后,在硬件上可选择16bit或8bit的数据格式 *2 1PIN为CS PIN *3 3PIN为CS PIN

Micro Wire BUS Pin Assignment CS [CS _ DU 🖂 □ NC SK 🗆 _ DU SK 🗀 DU ☐ GND BR93Gxx-3B DI 🗀 DI 🔚 □ NC cs _ ORG _ DO DO _ GND DI DO 🗆 __ GND SK 🗀 可选择位形式 (8bit or 16bit) BR93LxxRxx-W系列兼容 旋转引脚

				Package					D	Supply	Current Consu	umption(Max.)	Write	Operating	Data
Part No.	I/F	Density (bit)	Package Name	Size (mm)	Thickness (mm)Max.	Ball Pitch (mm)	RESIN COATING	Pull-up Resister	Bit Format (word × bit)	Voltage (V)	Operating (mA)	Standby (µA)	Cycle Time(ms)	Temperature	Retentior (years)
BU9833GUL-W	I ² C	2K	VCSP50L1	x: 1.27 y: 1.50	0.55	0.5	V	-	256 × 8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BU9847GUL-W	I ² C	4K	VCSP50L1	x: 1.95 y: 1.06	0.55	0.5	V	-	512×8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BU9889GUL-W	I ² C	8K	VCSP50L2	x:1.60 y:1.00	0.55	0.5	~	1/-/	1K×8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BRCB008GWZ-3	I ² C	8K	UCSP30L1	x: 0.94 y: 0.94	0.33	0.4	- 1	-	1K×8	1.7 to 3.6	2	2	5	-40 to +85	40
BRCB016GWL-3	I ² C	16K	UCSP50L1	x:1.10 y:1.15	0.55	0.4	V	-	2K×8	1.7 to 3.6	2	2	5	-40 to +85	40
BRCD016GWZ-3	I ² C	16K	UCSP35L1	x:1.30 y:0.77	0.40	0.4	V	-4	2K×8	1.7 to 3.6	2	2	5	-40 to +85	40
BRCG016GWZ-3	I ² C	16K	UCSP30L1A	x: 0.82 y: 0.82	0.33	0.4	V	\ <u>-</u>	2K×8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BRCF016GWZ-3	I ² C	16K	UCSP30L1	x: 0.86 y: 0.84	0.35	0.4	- \	-	2K×8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BRCA016GWZ-W	I ² C	16K	UCSP30L1	x:1.30 y:0.77	0.35	0.4	10-	9	2K×8	1.7 to 3.6	2	2	5	-40 to +85	40
BRCB032GWZ-3	I ² C	32K	UCSP30L1	x:1.45 y:0.77	0.33	0.4	-	-	4K×8	1.7 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BRCH064GWZ-3	I ² C	64K	UCSP35L1A	x:1.50 y:1.00	0.33	0.4	V	-	8K×8	1.6 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BRCB064GWZ-3	I ² C	64K	UCSP30L1	x:1.50 y:1.00	0.35	0.4	-	WP	8K×8	1.6 to 5.5	3.9	2	5	-40 to +85	40
BRCE064GWZ-3	I ² C	64K	UCSP25L1	x:1.50 y:1.00	0.30	0.4	-	-	8K×8	1.6 to 5.5	2	2	5	-40 to +85	40
BU9897GUL-W	I ² C	128K	VCSP50L2	x: 2.44 y: 1.99	0.55	0.5	~	-	16K×8	1.7 to 5.5	2.5	2	5	-40 to +85	40
BU9832GUL-W	SPI	8K	VCSP50L2	x : 2.09 y : 1.85	0.55	0.5	~	-	1K×8	1.8 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	40
BU9829GUL-W	SPI	16K	VCSP50L1	x : 1.74 y : 1.65	0.55	0.5	~	-	2K×8	1.6 to 3.6	2	1	5	-30 to +85	10
BR25S128GUZ-W	SPI	128K	VCSP35L2	x : 2.00 y : 2.63	0.40	0.5	~	-	16K×8	1.7 to 5.5	2*	2	5	-40 to +85	40
BU9891GUL-W	MW	4K	VCSP50L1	x:1.60 y:1.00	0.55	0.5	~	-	256×16	1.7 to 5.5	3	2	5	-40 to +85	40

WL-CSP EEPROM: *Vcc = 2.5V

Plug & Play用EE	PROM 用于	存储器模块							
Part No.	Package :	and Suffix VSON008X2030	Bit Format (word × bit)	Supply Voltage (V)	Clock Frequency (kHz)	Write Cycle Time (ms)	Endurance (times)	Data Retention (years)	Write Protect
BR34L02	FVT-W	-	256 × 8	1.7 to 5.5	100*1/400*2	5	10 ⁶	40	Onetime ROM write protect
BR34E02	FVT-3	NUX-3	256 × 8	1.7 to 5.5	400	5	10 ⁶	40	Settable write protect Onetime ROM write protect

Plug & Play用EEPROM 用于存储器模块: *1: Vcc=1.7~5.5V *2: Vcc=2.5~5.5V

Tiug & Flay MLLI HOW M 1 17 Mg	四天火 . " !	. VCC=1.7	0.04	V00=2.0 -0	.0 v										
Plug & Play用EE	Plug & Play用EEPROM 用于显示器														
Part No.	SOP8	SOP-J8	Pack SSOP-B8	SOP14		SSOP-B16	VSON008X2030	Function Descriptions	Bit Format (word × bit)	Supply Voltage (V)	Clock Frequency (MHz)	Write Cycle Time (ms)			
BR24C21	F	FJ	FV	-	-	-	-	Supports DDC1/ DDC2 for displays	128×8	2.5 to 5.5	100/400	10			
BU9882	-	-	-	F-W	FV-W	-	-	Dual-port type compatible with DDC2 for displays	128 × 8 × 2ch	2.5 to 5.5	100/400	10			
BU9883	-	-	-	-	-	FV-W	-	2Kbit × 3ch EEPROM for HDMI ports	256 × 8 × 3ch	3.0 to 5.5	400	5			
BU99022	-	-	-	-	-	-	NUX-3	2Kbit × 2ch type	256 × 8 × 2ch	1.7 to 5.5	400	5			

DDC是Video Electronics Standards Association的商标。



车载用EEPROM

	EEPROM 工作 I ² C BI	UC EED	DOM () Wire	DD24A	vy VA/R	A 宏 和								
105 C	, TIFICE	US EEP			DNZ4A	KX-VVI	N자기		la .a						
Р	Part No.		Package and Suff		MSOP8	Density (bit)	Bit Format (word × bit)	Supply Voltage (V)	Operating (mA)	Standby (µA)	Write Cycle Time (Max.)(ms)	Operating Temperature (°C)	Endurance (times)	Data Retention (years)	Automotive Grade AEC-Q100
BR24/	BR24A01A F-WM		FJ-	-WM	-	1K	128×8	2.5 to 5.5	2	2	5				
BR24/	A02	F-WM	FJ-	WM	FVM-WM	2K	256×8	2.5 to 5.5	2	2	5	-			
BR24/	BR24A04		FJ-	WM	_	4K 8K 16K 32K	512×8	2.5 to 5.5	2	2	5	-40 to +105	10 ⁶	40	YES
BR24A08 BR24A16 BR24A32		F-WM	FJ-	WM	_		1K×8	2.5 to 5.5	2	2	5				
		F-WM	FJ-	WM	-		2K×8	2.5 to 5.5	2	2	5				
		F-WM		_	-		4K×8	2.5 to 5.5	3	2	5				
BR24A64		F-WM			-	64K	8K×8	2.5 to 5.5	3	2	5				
85°C	工作 Microv	wire I ² C			И (2-Wir	e) BR	24Txx-3	BAM系列	T						
Р	Part No.	SOP8		and Suffix P-J8	TSSOP-B8	Density (bit)	Bit Format (word × bit)	Supply Voltage (V)	Operating (mA)	Standby (µA)	Write Cycle Time (Max.)(ms)	Operating Temperature (°C)	Endurance (times)	Data Retention (years)	Automotiv Grade AEC-Q10
7 BR241	BR24T512		F-3AM FJ-3AM		FVT-3AM	3AM 512K	64K×8	1.7 to 5.5	4.5 3	5	-40 to	106		VEO	
7 BR241	T1M	F-3AM	FJ-	ЗАМ	-	1M	128K×8	1.7 to 5.5	4.5	3	5	+ 85	10 ⁶	40	YES
125℃	工作 Micro	wire B	US EEP	ROM (3-Wire)	BR93	Hxx-2C	系列						1	
Р	Part No.	SOP8	Package SOP-J8	and Suffix	MSOP8	Density (bit)	Bit Format (word × bit)	Supply Voltage (V)	Current Cons Operating (mA)	_	Write Cycle Time (Max.)(ms)	Operating Temperature (°C)	Endurance (times)	Data Retention (years)	Automotiv Grade AEC-Q10
BR93I	H46	RF-2C	RFJ-2C	RFVT-2C	RFVM-2C	1K	64×16	2.5 to 5.5	3	10	4				
BR93I	H56	RF-2C	RFJ-2C	RFVT-2C	RFVM-2C	2K	128×16	2.5 to 5.5	3	10	4			6	
BR93I	H66	RF-2C	RFJ-2C	RFVT-2C	RFVM-2C	4K	256×16	2.5 to 5.5	3	10	4	-40 to + 125	10 ⁶	100	YES
BR93I	H76	RF-2C	RFJ-2C	RFVT-2C	RFVM-2C	8K	512×16	2.5 to 5.5	3	10	4				
BR93I	H86	RF-2C	RFJ-2C	RFVT-2C	RFVM-2C	16K	1K×16	2.5 to 5.5	3	10	4				1
105℃	工作 Micro	wire B	US EEP	ROM (3-Wire)	BR93	Axx-WI	/[系列							
BR93/	A46	RF-WM	RFJ-WM	RFVT-WN	RFVM-WM	1K	64×16	2.5 to 5.5	3	2	5				
BR93/	A56	RF-WM	RFJ-WM	RFVT-WN	RFVM-WM	2K	128×16	2.5 to 5.5	3	2	5				
BR93/	A66	RF-WM	RFJ-WM	RFVT-WN	RFVM-WM	4K	256×16	2.5 to 5.5	3	2	5	-40 to + 105	10 ⁶	40	YES
BR93/	A76	RF-WM	RFJ-WM	RFVT-WN	RFVM-WM	8K	512×16	2.5 to 5.5	3	2	5				
BR93/	A86	RF-WM	RFJ-WM	RFVT-WN	RFVM-WM	16K	1K×16	2.5 to 5.5	3	2	5				
125℃ 工作 SPI BUS EEPROM BR25Hxxx-2C系列															
BR25I	H010	F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	1K	128×8	2.5 to 5.5	4	10	4		10°	100	YES
BR25I	H020	F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	2K	256 × 8	2.5 to 5.5	4	10	4				
BR25I	_	F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	4K	512×8	2.5 to 5.5	4	10	4				
BR25I	_	F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	8K	1K×8	2.5 to 5.5	4	10	4	-40 to +125			
BR25I	C	F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	16K	2K×8	2.5 to 5.5	4	10	4				
BR25I		F-2C	FJ-2C	FVT-2C	FVM-2C	32K	4K×8	2.5 to 5.5	4	10	4				
BR25I BR25I		F-2C F-2C	FJ-2C FJ-2C	FVT-2C	-	64K 128K	8K×8 16K×8	2.5 to 5.5	5.5	10	4				
				- 10 EE	- DOM B			2.5 to 5.5	5.5	10	4				
	工作 内置E			FVT-2AC	1	T		T T	6.5	10					
BR25I BR25I		F-2AC F-2AC	FJ-2AC FJ-2AC	FVT-2AC		64K 128K	8K×8 16K×8	2.5 to 5.5 2.5 to 5.5	5.5	10	4	-40 to	10 ⁶	100	YES
BR25I		F-2AC	FJ-2AC	- FV I-ZAC		256K	32K×8	2.5 to 5.5	5.5	10	4	+ 125	10	100	IES
	:工作 SPI B								1						
BR25/		F-3M	FJ-3M	FVT-3M		256K	32K×8	2.5 to 5.5	4	10	5				
BR25/		F-3M	FJ-3M	FVT-3M	_	512K	64K×8	2.5 to 5.5	4	10	5	-40 to	10 ⁶	100	YES
					+							+105			

BR25A1M

F-3M

FJ-3M

128K×8 2.5 to 5.5

10

1M



FeRAM

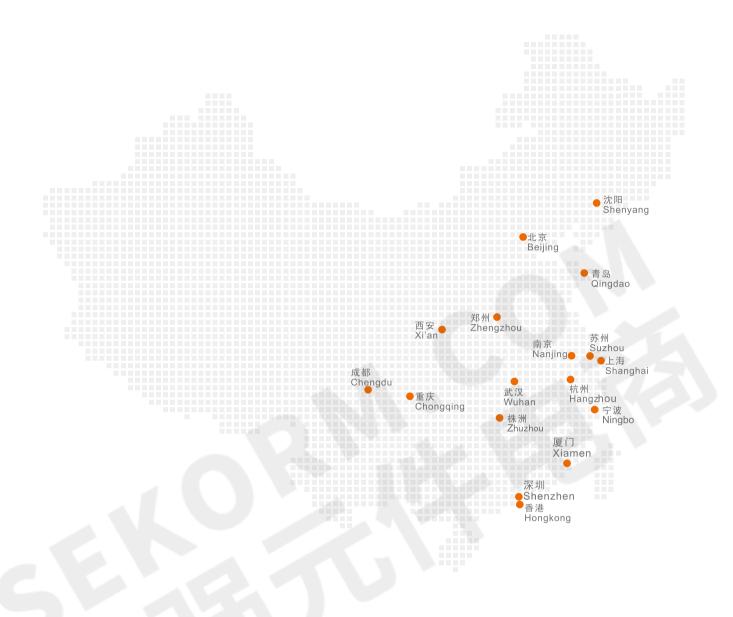
铁申随机存取存储器

(LAPIS Semiconductor产品)

	坎电飑机计拟 针	阳陌							(LAPIS Sell	iicondi	JCIOI) HH)	
	Parallel BUS FeRAM											
	Part No.	Memory Density (bit)	Configuration (word×bit)	Supply Voltage (V)	Operating Speed	Read/Write Endurance (times)	Data Retention (years)	Operating Temperature Ta(°C)	Package	Halogen Free Support*1	Automotive Grade*2	
	MR48V256C	256K	32K×8	2.7 to 3.6	t _{RC} =150ns	10 ¹²	10	-40 to +85	TSOP(I)28	-	YES	
	I ² C BUS FeRAM MR44Vxxxx系列											
	MR44V064A	64K	8K×8	2.5 to 3.6	fclk=3.4MHz	10 ¹²	10	- 40 to +85	SOP8	~		
	MR44V064B	64K	8K×8	1.8 to 3.6	fclk=3.4MHz					~	YES	
Nev	7 MR44V100A	1M	128K×8	1.8 to 3.6	fclk=3.4MHz					~	ı	
	SPI BUS FeRAM MR45Vxxxx系列											
	MR45V032A	32K	4K×8	2.7 to 3.6	fclk=15MHz							
	MR45V064B	64K	8K×8	1.8 to 3.6	fclk=40MHz	- 10 ¹²	10	- 40 to +85	SOP8	~	YES	
	MR45V256A	256K	32K×8	3.0 to 3.6	fclk=15MHz						ı	
New	7 MR45V100A	1M	128K×8	1.8 to 3.6	fcik=40MHz				SOP8	~	YES	
	,								DIP8	~	-	
	MR45V200A	2M	256K×8	2.7 to 3.6	fclk=34MHz				DIP8	~	-	

^{*1:}带无卤素标记 / 表示着有无卤素产品。 详细内容请咨询销售人员。 *2:关于AEC-Q100,请咨询销售人员。

www.rohm.com.cn



SEKORM 世强

全球先进元件分销

服务热线: 40088 73266



深圳总部

深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座23楼邮编: 518129

各地办事处详情请点击: https://www.sekorm.com/contact/